



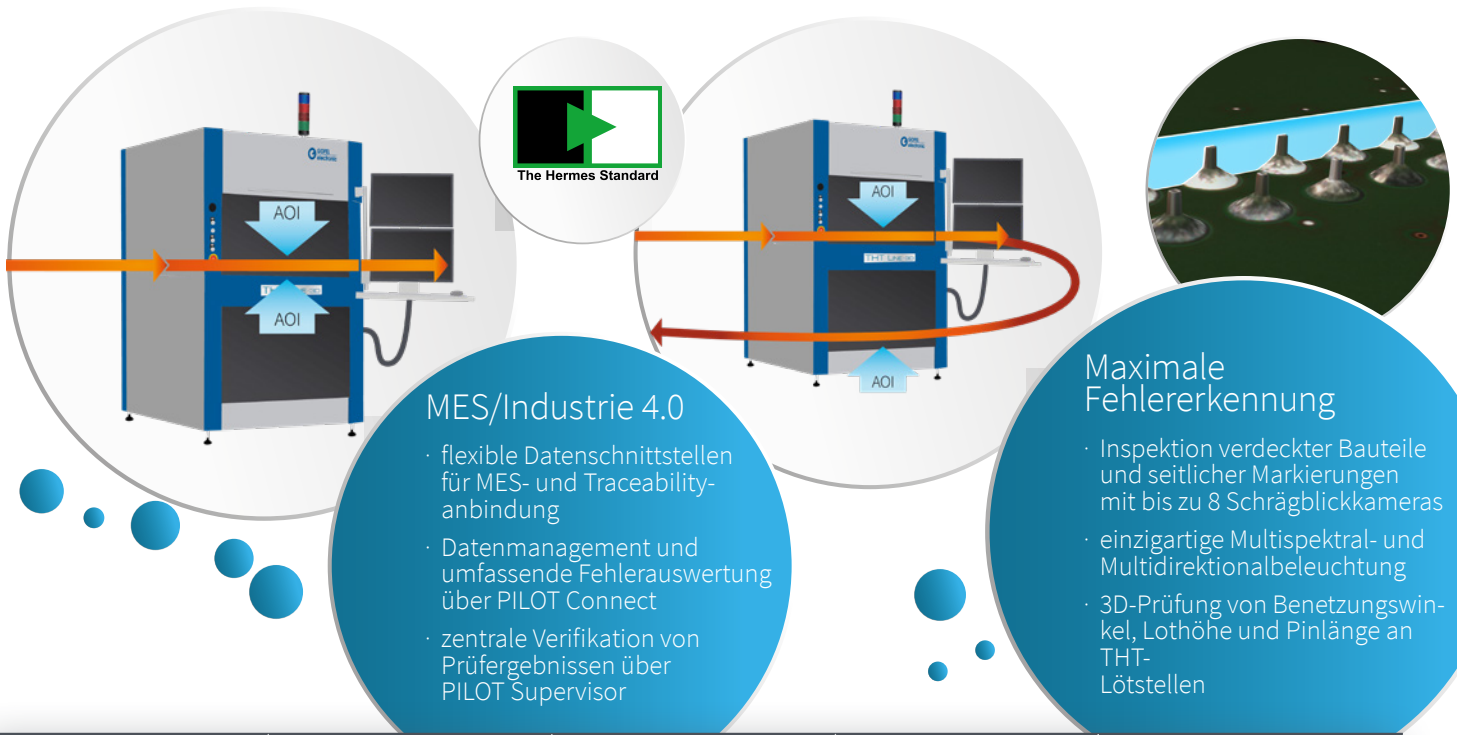
THT Line, THT Line·3D

AOI-System für THT-Baugruppen



- Inspektion von THT-Bauteilen, THT-Lötstellen und wellengelöteten SMD-Bauelementen
- beidseitige Inspektion von THT-Baugruppen im oberen oder unteren Transportmodul, mit oder ohne Werkstückträger
- 3D-Inspektion und Pinhöhenmessung für THT-Lötstellen





Parameter	2D-AOI-Modul Bauteilseite	3D-AOI-Modul Bauteilseite	2D-AOI-Modul Lötseite	3D-AOI-Modul Lötseite
Integrationsmöglichkeit der AOI-Module	im oberen Transportband	im oberen Transportband	im oberen oder unteren Transportband	im oberen oder unteren Transportband
Bilddaufnahme	orthogonale Kamera (telezentrisch), bis zu 8 Schrägblick-kameras	3D-Kameramodul	orthogonale Kamera (telezentrisch)	3D-Kameramodul
max. Inspektionshöhe	bis zu 80 mm	bis zu 35 mm		bis zu 35 mm
Inspektionsgeschwindigkeit	bis zu 100 cm ² /s			
max. Inspektionsbereich	540 mm x 450 mm			
max. Werkstückträgergröße	bis zu 620 mm x 510 mm			
Bauteilfreiheit	oberhalb Baugruppe: bis zu 135 mm (2D AOI)/bis zu 60 mm (3D AOI) unterhalb Baugruppe: bis zu 40 mm			

Technische Daten Gesamtsystem

Energiebedarf	230 VAC / 2 kVA, Druckluft 6 bar, Verbrauch < 20 l/h
Transportsystem	Bandtransport für Baugruppen mit oder ohne Werkstückträger
Transportrichtung	links-rechts, rechts-links, links-links, rechts-rechts
Inline-Schnittstelle	SMEMA, Siemens, Sensor
Abmessungen (B x T x H)	1150 mm x 1300 mm x 1800 mm

Optionen

Lasert-Höhenmesssystem
Barcode-, DMC- oder RFID-Lesesystem
Systemkonfiguration für manuelle Zufuhr

Effizienter Fertigungseinsatz

- Inspektion der Lötseite im oberen Transportmodul oder in der unteren Rückführung
- parallel und unabhängig arbeitende AOI-Module in einem System
- vollautomatische Erstellung und Optimierung von Prüfprogrammen für THT-Lötstellen mit MagicClick